



ポイント・スプレー搭載
セレクトイブトレースはんだ付け装置
オール・イン・ワン・タイプ

新製品

STS-5050SJ



◀ 写真のカバーはオプションになります



基板挿入部品の後付専用はんだ付け装置

小スペース及びスルーホール内へフラックスを塗布できる
サーボジェットフラクサーを搭載したポイントはんだ付け装置です。
プログラムされたはんだ付け部分に基板下面より自動にXYZユニット
にてフラックスを塗布し、安定した噴流波にて確実な、はんだ付けを
おこないます。大きめの多層基板、重量部品などにも対処可能です。



安定した噴流による
噴流ノズルのはんだ付け



特殊開発噴流はんだ槽搭載
安定したノズル先端温度



スルーホールを狙い撃ち
できる高精度ノズル

SEITEC CO., LTD

MODEL : STS-5050SJ

セレクトティブトレース自動はんだ付け装置・サーボジェットフラクサー搭載、オール・イン・ワン・タイプ
標準仕様

STS-5050SJ		
システム構成	1. はんだ槽ユニット 2. 窒素熱風ユニット 3. X・Y・Z 駆動部 4. 基板セット部 5. 本体部 6. 電源、制御部 7. 窒素・エア供給部 8. パソコン[本体・キーボード・マウス・モニタ・A4スキャナ] 9. サーボジェットフラクサー	
適応基板寸法	対応基板寸法 厚さ 基板端面デッドスペース 高さ搭載部品クリアランス 基板の取り付け方法 作業高さ	最小:50×50mm 最大:500×500mm 0.8mm～3.0mm 3mm 以上 基板上面 50mm 以下 基板下面 15mm 以下 サブキャリアに基板セット FL900±20mm
本体寸法	(L)1200×(W)1232×(H)1090mm(排気筒含まず)	
本体重量	約 250kg	
電源・電圧・容量	AC200V 3P 60/50Hz 3kVA	
エアー	工場エアー 0.4Mpa 以上必要	
窒素	圧力 0.2Mpa、純度 99.9%以上(推奨)、供給量 2m³/h 以上必要	
排気ダクト容量	3m³/h以上が必要	
塗装色	白系アイボリー	
各ユニット仕様		
サーボジェット フラクサー部 (ポイントスプレー部)	ジェットノズル ノズルの経口 塗布量調整 集塵 タンク	ジェットノズル 0.254mm PC の画面上より設定 排気ファン(内蔵なし) フラックスと洗浄用タンク
パソコン部	OS データー登録 プログラム作成	Windows 7 Professional データー入力、500 ファイル(最大) オリジナルデジタイザーソフト搭載
噴流はんだ槽部	はんだ槽材質:鉄鋳物鍋 はんだ槽内構成部品材質 :SUS-304 チツ化処理 はんだ量:約 8kg ヒーター容量:約 1.6kW はんだ溶解時間:30 分	温度上限設定:300℃ 噴流モータ:DC サーボモーター駆動 温度制御方式:温度調節器による PID 制御 ノズル:内径φ6、φ8、φ10、φ12 より 2ヶ選択 *ノズルは消耗品となります
オプション	基板セット部カバー(インターロック付き); シグナルライト(警報ブザー) はんだ槽高温インターロック(サーモスタットにて監視) 酸素濃度監視警報器(検出時動作=非常停止); サブキャリア 1 台(基板反り防止対応型)	

製造元

セイテック株式会社

(旧東京生産技研株式会社)

〒193-0836 東京都八王子市日吉町 6-13

TEL 042-625-5161 FAX 042-622-3227

詳しい情報は <http://www.seitec.biz>